证券代码：600226　　证券简称：亨通股份　　公告编号：2026-070

浙江亨通控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司	55,000.00 万元	101,864.58 万元	是	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	206,864.58
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	56.98
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日与中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以下简称“中行龙泉驿支行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 001 号），公司为全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）向中行龙泉驿支行申请的不超过 55,000.00 万元贷款提供连带责任保证。具体详见公司披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-030）。

根据亨通铜箔业务发展需要，公司于近日与中行龙泉驿支行签署了《最高额保证合同补充合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 001 号补字 01 号），将《最高额保证合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 001 号）约定的公司为亨通铜箔向中行龙泉驿支行申请担保债权最高额度由 55,000.00 万元变更为 20,000.00 万元 。

2026 年 11 月 23 日，公司与中行龙泉驿支行、兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业苏州分行”）构成的银团签署了《银团贷款保证合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 002 号），就亨通铜箔向银团申请不超过 35,000.00 万元贷款提供连带责任担保。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司第九届董事会第二十七次会议和 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为全资子公司亨通铜箔提供额度不超过人民币 150,000.00 万元的担保，并授权公司董事长或其授权代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日和 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-062）和《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-072）。

公司第九届董事会第三十五次会议和 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为全资子公

司亨通铜箔提供新增担保额度不超过60,000.00万元的担保，并授权公司董事长或其授权代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于2026年6月16日和2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-037）和《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	张卫强		
统一社会信用代码	91510600MA7EDEMJ74		
成立时间	2021年12月8日		
注册地	四川省德阳市旌阳区八角井街道雪山路888号（南湖路与雪山路交汇处西南角）		
注册资本	123,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	274,826.30	233,672.08
	负债总额	208,081.41	197,555.48
	资产净额	66,744.89	36,116.60

	营业收入	189,290.94	132,232.06
	净利润	-166.08	-11,046.45

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同补充合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 001 号补字 01 号）主要内容如下：

债权人：中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行

被担保人：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

保证人：浙江亨通控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过人民币 20,000.00 万元

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：本合同项下主债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（二）《银团贷款保证合同》（编号：2026 年 HTKG 保字第 002 号）主要内容如下：

债权人（银团成员）：中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行、兴业银行股份有限公司苏州分行

被担保人：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

保证人：浙江亨通控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：不超过人民币 35,000.00 万元（其中，中行龙泉驿支行 24,500.00 万元，兴业苏州分行 10,500.00 万元）

保证期间：1、本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下全

部债务履行期限届满之日起三年。2、保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司亨通铜箔提供担保，有助于满足其经营发展资金需求，推进公司转型发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度范围。被担保人亨通铜箔生产经营正常、资信状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；于2026年6月15日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为下属控股企业提供的对外担保总额为206,864.58万元，占公司最近一期经审计净资产的56.98%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日